

## 公司概況資料表

以下資料由天虹科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

### 認購相關資訊

#### 公司簡介

#### 風險事項說明(申請登錄戰略新三板公司適用)

#### 主要業務項目

#### 最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

#### 最近五年度簡明資產負債表

#### 最近三年度財務比率

公司名稱：天虹科技股份有限公司（股票代號：6937）

申請登錄：一般板 戰略新三板

董事長	黃見駱	
總經理	黃見駱	
資本額	606,772,630元	
輔導推薦證券商	元大證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司	
主辦輔導券商聯絡人電話	元大證券股份有限公司 劉佐 (02)2718-1234#6647	
註冊地國	該公司非屬外國發行人，故不適用	
訴訟及非訟代理人	該公司非屬外國發行人，故不適用	
輔導推薦證券商認購天虹科技股份有限公司股票之相關資訊		
證券商名稱	主辦	協辦
	元大證券股份有限公司	群益金鼎證券股份有限公司
認購日期	112年1月3日	
認購股數（股）	1,000,000	40,000
認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率	1.65%	0.07%
認購價格	81元/股	

認購價格之訂定  
依據及方式

目前股票價值的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。證券投資分析常用之股票評價方法主要包括：

- (1)市場法：本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)及股價淨值比法(Price/Book Value Ratio, P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整。
- (2)成本法：係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。
- (3)現金流量折現法：採用未來現金流量作為公司價值之評定基礎。

以上股票評價方法，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反映資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本無法精確掌握；股價淨值比法較適用於獲利不穩定，或成熟產業但獲利波動劇烈的景氣循環公司，而該公司屬獲利穩定之產業，故本推薦證券商僅就本益比法作為評估基準。

天虹科技股份有限公司(以下簡稱天虹或該公司)主要從事半導體設備機台及零組件之研發及銷售。經參考國內已上市櫃從事半導體設備機台及零備件公司之同業資料，選擇業務型態、產品性質、公司規模及營業項目較為相近者作為採樣同業：(1)家登(上櫃公司，股票代號3680)主要營業項目為光罩解決方案產品、機台設備產品、晶圓解決方案產品(2)辛耘(上市公司，股票代號3583)主要營業項目為半導體/LED/Solar/LCD等製程機台設備代理研發製造、晶圓再生技術研發與服務化學分析儀器代理技術研發製造(3)意德士(上櫃公司，股票代號7556)主要營業項目為半導體製程設備之精密零組件與材料、製程次系統之維修。

茲彙總採樣同業最近三個月(111年9月~11月)之平均本益比如下：

單位：倍

月份	111年 09月	111年 10月	111年 11月	平均
採樣同業				
家登(3680)	32.05	24.6	22.64	26.43
辛耘(3583)	10.44	9.57	10.79	10.27
意德士(7556)	18.91	18.27	18.43	18.54
上市股票-半導體業	11.11	10.63	12.03	11.26
上櫃股票-半導體業	11.85	11.48	14.08	12.47

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及證券交易所網站

由上表得知，採樣同業及上市櫃半導體業類股最近三個月(111年9月~111年11月)之平均本益比約介於10.27~26.43倍之間；另依據該公司最近四季(110年第三季~111年第二季)之稅後盈餘160,845千元，以目前股數60,677千股計算，每股稅後盈餘為2.65元，按上述本益比區間計算其參考價格，其參考價格區間約為27.22~70.04元。惟本輔導推薦券商與公司議定之股票認購價格為81元，略高於前述參考價

格，係考量該公司經營績效、目前獲利情形；另考量111年11月辦理現金增資價格每股為80元，該現金增資案尚有外部股東參與認購等因素。

綜上，本次興櫃認購價格之訂定除參酌國際慣用之各項評價法計算天虹之合理價格，並考量該公司之經營績效、獲利情形、所處市場環境、產業未來成長性，本推薦輔導證券商與天虹共同議定之興櫃認購價格為每股81元，雖高於依採樣同業及上市櫃半導體業類股算出之本益比區間，惟評估尚屬合理。

## 公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

### 一、公司簡介

天虹科技股份有限公司設立於民國91年7月17日，公司目前主要從事半導體設備機台及半導體設備零組件之研發、製造以及銷售。半導體設備零件包含高真空波紋管、工業用雙硬碟、應用於半導體蝕刻(ETCH)/化學氣相沉積(CVD)/物理氣相沉積(PVD)/快速高溫製程(RTP)/離子植入(Imp)等機台設備之精密陶瓷、精密石英、金屬、工程塑料等零組件以及機台維修、拆除、除汙與移機等服務；半導體機台設備包含 PVD、ALD、Powder ALD、Bonder、Debonder、Laser Lift-off 及 Skiwar 等製程設備。截至111/11/30止實收資本額為新台幣606,773仟元。

### 二、歷史沿革

民國年月	重要沿革
91年7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 正式成立「天虹科技股份有限公司」，設立實收資本額為新台幣5,000千元整。</li> <li>• 陶瓷材料為主要銷售產品。</li> </ul>
92年12月	成立工程維修技術團隊，開始經營半導體設備用及配管工程用等各類閥件的翻修工作。
93年7月	現金增資新臺幣20,000千元，公司增資後實收資本額為新台幣25,000千元整。
95年1月	現金增資新臺幣40,000千元，公司增資後實收資本額為新台幣65,000千元整。
98年2月	通過 ISO9001/97年版品質認證。
99年8月	購入南科辦公室，成立南科辦事處。
103年12月	現金增資新臺幣30,000千元，公司增資後實收資本額為新台幣95,000千元整。
104年8月	現金增資新臺幣5,000千元，公司增資後實收資本額為新台幣100,000千元整。
105年11月	榮獲 GlobalFoundries 傑出供應商獎。
106年3月	成立半導體設備開發處，研發製造國產半導體機台。
106年4月	現金增資新臺幣20,000千元，公司增資後實收資本額為新台幣120,000千元整。
106年6月	現金增資新臺幣20,000千元，公司增資後實收資本額為新台幣140,000千元整。
106年12月	現金增資新臺幣25,000千元，公司增資後實收資本額為新台幣165,000千元整。
107年6月	物理氣相沉積(PVD)、鍵合機(Bonder)及解鍵合機(Debonder)等設備問市。
107年8月	財產抵繳增資新臺幣4,000千元，公司增資後實收資本額為新台幣169,000千元整。
108年10月	原子層沉積(ALD)設備問市。
109年3月	購入新竹縣湖口工業區廠房，土地面積2,960平方公尺，建築物面積11,086.84平方公尺，成為公司半導體設備開發的研發總部。
109年9月	與國研院儀科中心合作共同開發12吋量產型叢集式ALD設備，並舉辦「12吋叢集式原子層沉積先進設備發表會」。
110年1月	現金增資新臺幣14,530千元，公司增資後實收資本額為新台幣183,530千元整。
110年3月	現金增資新臺幣117,410千元，公司增資後實收資本額為新台幣300,940千元整。
110年8月	ALD 設備獲晶電採用，為臺灣第一家被量產的 ALD 薄膜製程本土設備商，並成功切入蘋果供應鏈。
110年9月	現金增資新臺幣54,980千元及財產抵繳增資47,208千元，公司增資後實收資本額為新台幣403,128千元整。
110年10月	竹北總公司與湖口設備研發總部先後通過 ISO9001/104年版品質認證。
110年12月	進行集團架構重組，新加坡 Gimtek Ptd. Ltd、鑫天虹(廈門)科技有限公司、傳晶電子(上海)有限公司與鑫虹先進股份有限公司成為公司100%持股之子公司。 現金增資新臺幣141,645千元，公司增資後實收資本額為新台幣544,773千元整。
111年5月	現金增資新臺幣12,000千元，公司增資後實收資本額為新台幣556,773千元整。
111年11月	現金增資新臺幣50,000千元，公司增資後實收資本額為新台幣606,773千元整。

通過 ISO 14001 認證。  
通過 ISO 45001 認證。

### 三、經營理念

天虹專注於本業之經營，重視技術之研發及業務行銷之拓展，建立以人才為本、成果共享、永續經營的企業經營理念，並專注於整合技術能力，以提供客戶高品質的服務及產品，與供應商及客戶一同成長。

### 四、未來展望

#### (1)短期業務發展計畫

近期業務發展重點將著重於如何擴大在車用晶片市場，也是所謂化合物半導體(第三代半導體)碳化矽(SiC)及氮化鎵(GaN)相關應用的設備市場佔有率。目前該公司開發的物理氣相沉積設備(PVD)、原子層沉積設備(ALD)、晶圓鍵合機及解鍵合機(Bonder/Debonder)都在化合物半導體領域，扮演關鍵製程的角色。可以藉由貼近市場的機會打破過去客戶使用歐美日系設備的習慣。同時在擴大化合物半導體設備市場佔有率的同時，緊密貼近幾位跨國性客戶做更緊密的戰略結合，為未來設備行銷國際化鋪路。

#### (2)長期業務發展計畫

緊密觀察地緣政治的氛圍，以及國際戰爭局勢對產業及供應鏈的影響，同時密切關心前段半導體復甦的信號，在開始復甦前，確定戰略布局是否可以跟上局勢變化，提前因應。同時在產品開發上，確保相關真空電漿技術可以橫向支援新產品 Descum 的開發，確認適當客人協助產品認證，讓 Descum 設備可以在未來除了協助該公司成長營業額，同時也可以成為協助該公司打進蝕刻市場的一個試金石。計劃公司上市之後，也可以啟動策略性併購，結合互補的夥伴、產品、供應鏈，進一步擴大該公司的基礎，為日後進軍國際市場奠基。

### 風險事項說明(登錄戰略新三板公司適用)

天虹科技股份有限公司係依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第三章規定申請股票登錄戰略新三板之公司，相關營運風險較高，且戰略新三板市場參與者之買方限合格投資人，請投資人特別注意。

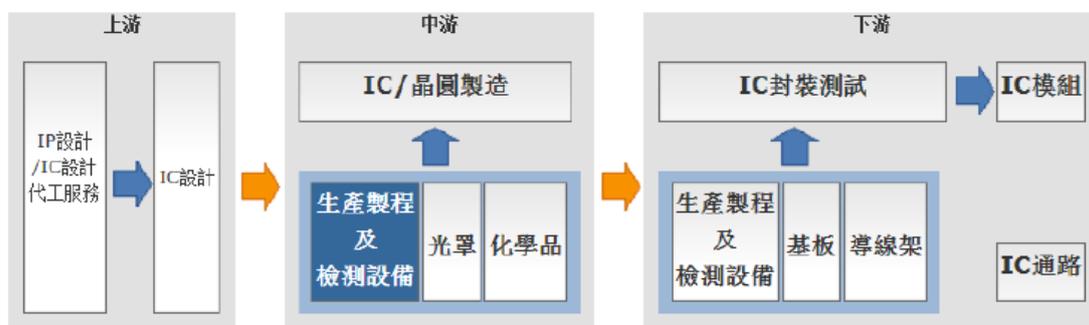
TOP ^

**主要業務項目：**

主要係從事高真空乾式電漿半導體設備機台及半導體設備零組件之研發、製造以及銷售。

**公司所屬產業之上、中、下游結構圖：**

半導體產業主要由上游 IC 設計廠商開始發展，接著中游 IC 製造、晶圓製造及相關製程與檢測設備等廠商相互配合及分工，將晶圓廠做好的晶圓，以光罩印上電路基本圖樣，再依靠各工段之製程設備，如氧化、擴散、蝕刻、沉積及離子植入等方法，將電路及電路上的元件，在晶圓上製作出來。該公司為半導體製程設備製造商與製程設備上的關鍵零組件供應商，即為中游廠商。最後，由下游廠商進行 IC 封裝，即將晶圓切割後的晶粒，用塑膠、陶瓷或金屬包覆，藉以保護晶粒免受碰撞及污染，且易於裝配，並達成晶片與電子系統的電性連接與散熱效果。茲將其上、中、下游關聯性列示如下：



資料來源：OTC 產業價值鏈資訊平台

產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度 營收金額(千元)	佔總營收 比重(%)
物理氣相 沉積(PVD)		主要製作半導體中的金屬層 做導電層及晶種層，或金屬 氮化物層做阻障層及過渡 層。	548,265	33.11
原子層沉 積(ALD)		主要製作半導體中的絕緣 層，取決高階梯覆蓋率及薄 膜緻密性的特點，在線寬逐 步微縮的趨勢下，傳統 PECVD 以不堪使用的條件 下，ALD有取代PECVD的特 性，使用領域越來越廣。		
晶圓鍵合 機 (Bonder)/ 晶圓解鍵 合機 (Debonder)		因為散熱及降低阻質的需求 下，晶片的厚度將被要求越 來越薄。在減薄的過程中， 為了提供晶圓足夠的機械強 度，以及晶片減薄後在接續 的晶片背面製程中能避免過 度翹曲，因此需要在減薄前 先將晶片鍵合一片支撐晶 片，其中對位的精度及鍵合 後的平坦度是設備工作的關		

		鍵。 鍵合晶片在完成減薄及晶背製程後，減薄的晶配需要跟支撐晶片脫離，如何能讓非常薄且帶翹曲的減薄晶片安全地跟支撐晶片脫離，支撐晶片可以回收使用，全程要在自動化的條件下完成，是本站的工作重點。		
設備零組件(Spares)		提供各種半導體設備生產所需的零備件，協助客戶以最高稼動率、最低生產成本、最低等待周期，來運轉生產設備。	732,860	44.26
其他		其他維修、勞務服務(例：拆移機)	374,587	22.63
合計			1,655,712	100.00

TOP ^

### 最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣千元

項目	年度	106年 (註1)	107年 (註1)	108年 (註1)	109年 (註1)	110年 (註1)	111年截至11月份止 (自結數)(註2)
營業收入		478,133	638,685	571,898	998,574	1,655,712	1,539,147
營業毛利		118,654	155,005	265,106	390,197	662,528	707,902
毛利率(%)		24.82	24.27	46.36	39.08	40.01	45.99
營業外收入及支出		13,767	24,119	11,297	68,367	50,853	51,910
稅前損益		15,562	24,333	89,373	77,090	241,538	308,656
稅後損益		11,752	21,223	53,244	61,787	224,620	303,282
每股盈餘(元)		0.71	1.26	3.15	1.63	4.57	5.46
股利發放	現金股利(元)	-	-	-	-	-	-
	股票股利(資本公積轉增資)(元)	-	-	-	-	-	-
	股票股利(盈餘轉增資)(元)	-	-	-	-	-	-

註1：上列各年度財務資料經會計師查核簽證。106~108年度僅編製採我國企業會計準則之個體報表，故僅揭露個體數字；該公司自110年度起適用國際財務報導準則並編製合併財務報表，附列109年度比較數字。

註2：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

## 最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項目	年度	106年 (註1)	107年 (註1)	108年 (註1)	109年 (註1)	110年 (註1)
流動資產		304,223	687,355	1,039,960	1,584,977	1,370,427
基金及長期投資		8,678	2,323	1,362	-	-
固定資產		134,931	181,143	180,230	812,549	725,001
無形資產		-	-	-	15,361	16,175
其他資產		46,692	44,792	16,985	50,977	79,877
資產總額		494,524	915,613	1,238,537	2,463,864	2,191,480
流動負債	分配前	243,697	603,564	873,243	1,629,645	820,016
	分配後	243,697	603,564	873,243	1,629,645	820,016
非流動負債		-	-	-	343,043	312,117
負債總額	分配前	243,697	603,564	873,243	1,972,688	1,132,133
	分配後	243,697	603,564	873,243	1,972,688	1,132,133
股本		165,000	169,000	169,000	183,530	544,773
資本公積		20,000	56,000	56,000	65,546	269,981
保留盈餘	分配前	65,827	87,049	140,294	62,419(註2)	239,799
	分配後	65,827	87,049	140,294	62,419(註2)	239,799
其他權益		-	-	-	-	4,794
歸屬於母公司業主之權益		註1	註1	註1	311,495	1,059,347
共同控制下前手權益		-	-	-	163,367	-
非控制權益		註1	註1	註1	16,314	-
股東權益總額	分配前	250,827	312,049	365,294	491,176	1,059,347
	分配後	250,827	312,049	365,294	491,176	1,059,347

註1：上列各年度財務資料經會計師查核簽證。106~108年度僅編製採我國企業會計準則之個體報表，故僅揭露個體數字；該公司自110年度起適用國際財務報導準則並編製合併財務報表，附列109年度比較數字。

註2：係因組織重組後，編製合併報表時，銷除合併個體關係人交易未實現損益所致。

TOP ^

## 最近三年度財務比率

項目		年度	108年	109年	110年
財務比率	毛利率(%)		46.36	39.08	40.01
	流動比率(%)		119.09	97.26	167.12
	應收帳款天數(天)		170	87	57
	存貨週轉天數(天)		652	522	324
	負債比率(%)		70.51	80.06	51.66

TOP ^

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[公開資訊觀測站!!](#)